

POP专用日本SUNSTAR底部填充胶1027S

产品名称	POP专用日本SUNSTAR底部填充胶1027S
公司名称	深圳市力邦泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山大道深意工业大厦516
联系电话	86-75588864001 13600411559

产品详情

日本盛势达sunstar可重工底部填充胶penguin cement 1027s是一款不仅具有很强的抗机械冲击性能，同时韧性增强的环氧底部填充胶。其最佳的玻璃化转变温度使得1027s不仅易于返修，同时具有优良的热循环性能。

penguin cement 1027s的粘度及流变特性使得其能快速的进行bga芯片的底部填充，尤其是在进行pop双层叠加芯片的上下两层同时填充时表现更佳。1027s可与市面上绝大多数的锡膏及助焊剂兼容，固化后形成完整一致的底部填充层（大大减少了气泡及空洞产生的概率）。

penguin cement

1027s已经全线使用在日本sony的xperia智能手机产品上，在北京bmc、烟台fih等得到大批应用！

欢迎来电来函洽询相关产品事宜！